

QFN除锡，编带，BGA植球，QFP镀脚，整脚加工

产品名称	QFN除锡，编带，BGA植球，QFP镀脚，整脚加工
公司名称	深圳市卓汇芯科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	加工方式:来料加工 工艺:提供有铅、无铅 加工设备:回流焊，返修台，加热台，植球台，编带机等
公司地址	深圳市宝安区西乡街道桃源社区广深路西乡段300号齐粤印机大厦2层A
联系电话	0755-36979941 15220066551

产品详情

BGA植球步骤

芯片烧烤（8-36H） 拖平BGA芯片焊盘 超声波清洗BGA芯片 选用适合锡球 手工植球/机器植球 清洗BGA芯片 编带（可直接上贴片机使用） 真空包装（可长时间保存） 上料盘（可供维修贴片方便取拿）

深圳*业BGA芯片处理一条龙服务，BGA拆板，除锡、除胶、植球、无球测试BGA功能，有球测试BGA功能,大批量植球订单，高难度植球测试等，因为有我们的专*，所以你的制程将会变得简单!卓汇芯--*业的BGA返修服务，芯片翻新，选择卓汇芯，就是选择*业的保证，选择卓汇芯就是对你的产品**的保证，不怕货比货就怕你不对比，我们提供的不仅仅是技术，我们更提供专*的服务!